

10-1-10 積層板差による実装欠陥／封装的缺陷因层压板而差别／ Solder joint defects due to different products used

【特徴】 積層板の差による実装はんだ周り欠陥の違い

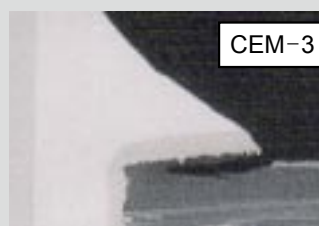
【特徴】 因层压板的差别，封装焊接周围的缺陷也有差别。

【Characteristics】 The solder joint defects occur due to the difference in thermal properties of different laminate products used.

【起因・判断ポイント・発生工程】 電子部品実装半だが冷却する際の熱歪みの差が積層板の種類によって若干異なってきたもの（電子部品実装工程）

【原因、判断要点、发生工序】 元件封装焊料冷却时的热应力不平衡，是因层压板有差别所引起的（元件封装工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Thermal deformation of laminates used is slightly different at a solder joint in cooling of solder in component mounting, causing the defects. (Component mounting process)



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 200

【注釋】
截面
显微镜倍率 × 200

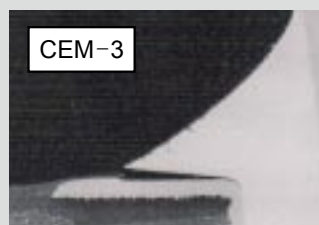
【Comments】
Microsection
Magnification: ×200



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 200

【注釋】
截面
显微镜倍率 × 200

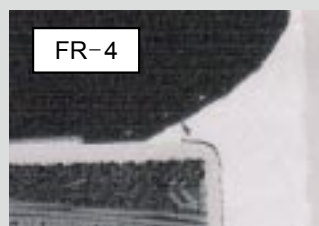
【Comments】
Microsection
Magnification: ×200



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 200

【注釋】
截面
显微镜倍率 × 200

【Comments】
Microsection
Magnification: ×200



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 200

【注釋】
截面
显微镜倍率 × 200

【Comments】
Microsection
Magnification: ×200

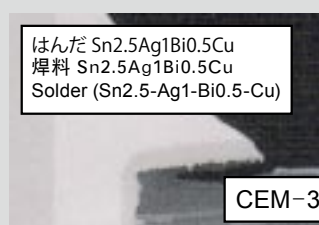
10-1-11 はんだ差による実装欠陥／封装的缺陷因焊料而差别／ Solder joint defects by use of solder of different makes

【特徴】 はんだの種類による実装はんだ周りの欠陥の違い

【特徴】 焊接周围的缺陷因不同类型的焊料而有差别。

【Characteristics】 Solder joint defects occur due to properties of different solders used in mounting.

【起因・判断ポイント・発生工程】 電子部品実装はんだが冷却する際の熱歪みの差がはんだの種類によって若干異なってきたもの（電子部品実装工程）



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
截面
显微镜倍率 ×

【Comments】
Microsection
Magnification: ×